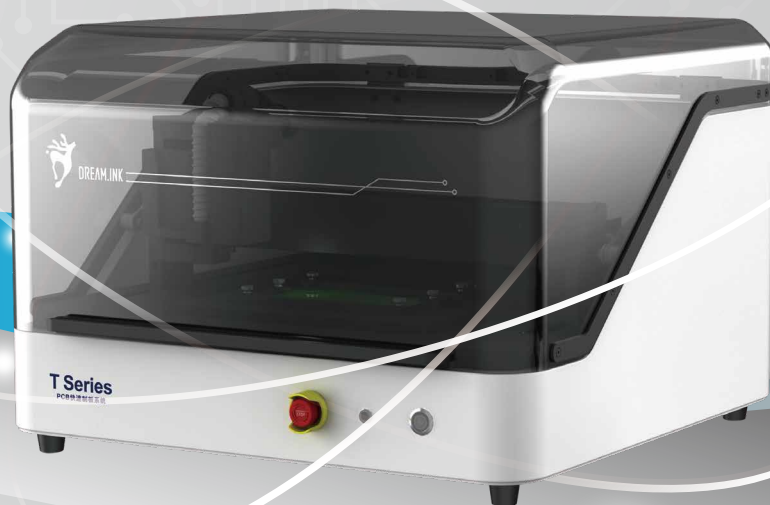


\* 可更换功能模块



# T Series PCB 快速制板系统

## 产品描述

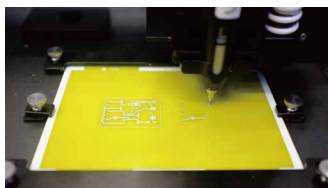
PRODUCT  
DESCRIPTION

T Series是基于非接触式打印技术的桌面级PCB快速制板系统,使用独家的液态金属复合材料,结合可控挤出技术,快速地完成打孔、孔金属化、线路打印、字符丝印、裁边,还可以打印焊锡膏,实现桌面级回流焊接。

T Series支持单面板、双面板的即时制作。满足电路板的快速打样、验证以及多品类电路板的小批量生产等需求,适用于教学支撑、工程实训、科技竞赛和创新创业等多种场景,是电子设计的必备工具。

## 工艺流程

PROCESS  
FLOW



打孔

孔金属化

线路打印

字符丝印

锡膏印刷

回流焊

裁切

## 产品特点

FEATURES

1

### 高度集成,全制程覆盖

采用模块化集成设计,体积小。通过模块的切换实现功能整合,轻松完成电路板制作核心制程。

2

### 效率提升,个性化制作

一块100mmx100mm幅面的双面PCB板的加工仅需90分钟,满足个性化的设计制作需求。

3

### 轻松上手,无忧式体验

清晰简洁的人机交互界面、流程化视频引导操作,与传统焊接工艺完美适配。

4

### 性能稳定,高质量呈现

系统经过完整测试,电路板成品性能稳定,电路性能指标满足多数应用场景需求。

## 技术参数

TECHNICAL  
PARAMETER

## T Series PCB快速制板系统参数及特点

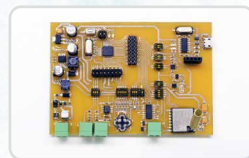
项目	分类	详细参数
设备参数	制板类型	单面板、双面板
	打印基材	FR4带阻焊油,厚度1.5mm
	制板尺寸	220mmx160mm、150mmx100mm
	最小线宽	0.1mm (4mil)
	最小线距	0.1mm (4mil)
	重复精度	0.05mm (2mil)
	打印速度	20mm/s
	钻孔孔径	0.4mm~3mm (系统配置0.4mm~1.6mm间隔0.1mm的13个规格,及2.6mm、3.0mm共计15个规格钻头,其余规格需用户自行购买)
	钻孔速度	15个/分钟
	孔化最小孔径	≥0.4mm (16mil)
	孔化速度	6个/分钟
	焊锡膏打印支持的最小封装	0603 (1.6mmx0.8mm)及QFP、SSOP 管脚中心间距0.8mm
	裁边形式	支持异形边,内圆角1mm
	裁边速度	≥15cm/min
	对位方式	视觉识别,自动对位;支持双面板Marking (定位)、Alignment (对齐) 功能
	操作系统	WINDOWS操作系统,支持Win7/Win8/Win10
	工程文件	支持 PcbDoc、Gerber 等格式文件
	主要功能	工程管理,自动定位,模组自动识别,支持选区打印、阵列打印、镜像打印、旋转打印等多种打印功能,支持打孔、孔金属化、裁边等功能,操作视频引导,出墨量、打印速度调节等
	通信方式	USB接口
输入电压	AC220V 50/60Hz	
额定功率	300w	
设备尺寸	606mmx620mmx429mm	
设备质量	45kg	
运行环境	工作温度	5°C~35°C
	贮存温度	-25°C~45°C
	相对湿度	相对湿度20%-80% 无冷凝 (建议≤40%)
	环境气压	海拔高度≤2000m, 86kPa - 106kPa (建议100kPa)
打印材料	材料类型	液态金属复合材料
	材料形态	浆料, 预灌装至打印管内部
	材料认证	通过Rohs认证
	电导率	3.3x106S/m
	固化时间	10mins
	固化温度	160°C
	信号传输性能	信号传输带宽3GHz(-3dB)
	电流承载能力	0.6A@0.5mm、2A@2.5mm

## 应用案例

APPLICATION  
CASE



无人机



环境监测电路



LED组件



平衡车



地址:北京市海淀区新技术大厦9层

网站:www.dreamink.cn

电话:010-82362762

E-mail:contact@dreamink.cn